

## A. 有關本公司及附屬公司的進一步資料

### 1. 註冊成立

本公司於2020年3月23日在中國成立為有限公司及於2025年4月25日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣270,000,000元。

本公司設有香港營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1928室，並於2025年5月21日根據公司條例第16部在香港向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。本公司的聯席公司秘書之一梁君慧女士已獲委任為我們在香港接收法律程序文件的代理，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

由於本公司在中國成立，我們須遵守中國相關法律法規。中國法律法規的若干相關內容及我們的公司章程概要載於「監管概覽」及「附錄四－公司章程概要」。

### 2. 本公司股本變動

除「歷史、發展及公司架構－主要公司發展」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本並無任何變動。

### 3. 附屬公司股本變動

截至最後實際可行日期，公司資料概要及主要附屬公司詳情載於本文件附錄一會計師報告附註1。

於緊接本文件日期前兩年內，以下附屬公司已註冊成立：

附屬公司名稱	成立地點	註冊成立日期	註冊資本
杭州力芯.....	中國	2024年3月5日	人民幣2百萬元
北京力積.....	中國	2024年7月26日	人民幣1百萬元
成都力積.....	中國	2024年5月24日	人民幣0.1百萬元
深圳力積.....	中國	2025年6月19日	7百萬美元

於緊接本文件日期前兩年內，以下附屬公司的股本發生變動：

附屬公司名稱	成立地點	變動日期	變動前的註冊資本	變動後的註冊資本
杭州力芯.....	中國	2024年8月19日	人民幣2百萬元	人民幣10百萬元

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司附屬公司的股本並無其他變動。

#### 4. 股東決議案

根據股東於2025年5月23日正式召開的股東大會上通過的決議案，股東議決（其中包括）：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1元的H股且該等H股於聯交所主板[編纂]；
- (b) 於行使[編纂]之前根據[編纂]將予發行的H股數目，及向[編纂]（或其代表）授出的[編纂]不得超過根據[編纂]發行的H股數目的15%；
- (c) 待向中國證監會備案完成，於[編纂]完成後，270,000,000股非上市股份將按一對一基準轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，公司章程獲有條件採納，並於[編纂]生效；及
- (e) 授權董事會或其授權人士處理與（其中包括）[編纂]、H股發行及於聯交所[編纂]有關的一切事宜。

#### 5. 購回自身證券的說明函件

以下各段載有（其中包括）聯交所規定就購回自身證券須收錄於本文件的若干資料。

##### (a) 購回的理由

董事會認為，購回股份將對本公司及其股東整體有利且符合本公司及其股東的整體最佳利益。其可增強投資者對本公司的信心，及對維護本公司在資本市場的聲譽起到正面的作用。董事會僅會於彼等相信有關購回股份對本公司及其股東整體有利之情況下會作出有關購回股份行動。

##### (b) 行使一般授權購回股份

待於股東週年大會上通過批准授出一般授權以購回股份的特別決議案後，董事會將獲授予一般授權以於相關期間內購回股份。購回股份的一般授權將於下列較早日期屆滿：

- (i) 於本公司下屆股東週年大會結束後，屆時該項授權將告失效，除非於該大會上通過特別決議案更新授權（不論無條件或附帶條件）；
- (ii) 本公司於下屆股東大會上通過特別決議案撤銷或更改決議案項下的授權；或
- (iii) 本公司於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或更改決議案項下的授權。

此外，我們需要向相關政府部門完成登記及批准程序，以便實際向董事會授予購回授權（如適用）。全面行使購回H股的一般授權將導致本公司於相關期間可購回最多相當於[編纂]已發行H股數目10%的股份。

**(c) 資金來源**

購回其股份時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、規例及法規可合法撥作有關用途的本公司內部資源（可包括盈餘資金及保留利潤）撥付。

公司章程賦予本公司權利購回其股份。倘公司章程及適用法律法規允許，任何待購回股份將被註銷或以庫存股份保留。本公司僅可利用原可撥作派息或分派的本公司資金或為此目的而發行新股的所得款項購回股份。本公司不得以非現金代價或以聯交所不時的交易規則規定以外的結算方式在聯交所購買證券。

**(d) 暫停購回**

在獲悉內幕消息後，上市公司不得於任何時間在聯交所購回其股份，直至有關消息已獲公佈為止。尤其是，於緊接以下較早者前一個月的期間：(i) 批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（不論上市規則有否規定）的董事會會議日期（根據上市規則首次知會聯交所的日期）；及(ii) 發行人根據上市規則公佈其任何年度或半年度業績，或季度或任何其他中期業績（不論上市規則有否規定）的最後限期，直至業績公佈日期為止，本公司不得於聯交所購回其股份，惟特殊情況則除外。

**(e) 緊密聯繫人及核心關連人士**

董事或（就彼等作出一切合理查詢後所知）彼等的任何緊密聯繫人目前概無意在購回股份的一般授權獲批准的情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼等目前有意在購回股份的一般授權獲批准的情況下向本公司或承諾向本公司出售股份。

上市公司不得在知情的情況下於聯交所向核心關連人士（即本公司或其任何附屬公司的董事、監事、最高行政人員或主要股東或彼等的任何緊密聯繫人）購買其股份，而核心關連人士亦不得在知情的情況下向上市公司出售其於本公司股份的權益。

**(f) 所購回股份的地位**

根據公司章程、上市規則及任何其他適用法律及法規，於購回H股後，本公司可按（其中包括）購回相關時間的市況及其資本管理需要註銷任何購回股份及／或將其作為庫存股份持有，或會因情況發展而有變動。

**(g) 收購影響**

倘購回任何股份導致股東於本公司表決權中所佔權益比例上升，則就收購守則而言，相關權益比例上升將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則規則26提出強制收購要約。

除上述者外，就董事所知，根據購回股份的一般授權進行任何購回不會產生收購守則所述的任何後果。

**(h) 一般事項**

就董事所深知，本節所載說明函件及建議購回股份均無不尋常之處。

倘購回股份的一般授權於任何時間獲全面行使，則可能對我們的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（與我們最近期刊發的經審計賬目所披露的狀況相比）。然而，倘行使購回股份的一般授權會對我們的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不建議行使購回股份的一般授權。

董事將根據上市規則及中國適用法律行使購回股份的一般授權。

**B. 有關我們業務的進一步資料**

**1. 重大合約概要**

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 田園智城、天津鼎鷹及本公司訂立日期為2025年3月11日的股權轉讓協議，據此，田園智城同意以將其於本公司的3.7731%股權轉讓予天津鼎鷹，代價為人民幣46,548,611.11元；
- (b) 田園智城、上海翹沐及本公司訂立日期為2025年3月11日的股權轉讓協議，據此，田園智城同意以將其於本公司的2.4318%股權轉讓予上海翹沐，代價為人民幣30,000,000元；
- (c) 田園智城、杭州孚芯及本公司訂立日期為2025年3月11日的股權轉讓協議，據此，田園智城同意以將其於本公司的2.4318%股權轉讓予杭州孚芯，代價為人民幣30,000,000元；
- (d) 田園智城、方沛英先生及本公司訂立日期為2025年3月11日的股權轉讓協議，據此，田園智城同意以將其於本公司的0.8106%股權轉讓予方沛英先生，代價為人民幣10,000,000元；

## 附錄五

## 法定及一般資料





- (e) 本公司、龍芯創溪、龍芯匯裕、天津鼎暉、深圳長臻、天津鼎鷹及方沛英先生訂立的日期為2025年4月27日的增資協議，據此，龍芯創溪同意以代價人民幣45,000,000元認購308,757股股份，龍芯匯裕同意以代價人民幣18,500,000元認購126,933股股份，天津鼎暉同意以代價人民幣30,000,000元認購205,838股股份，深圳長臻同意以代價人民幣30,000,000元認購205,838股股份，天津鼎鷹同意以代價人民幣25,000,000元認購171,531股股份，及方沛英先生同意以代價人民幣10,000,000元認購68,613股股份；
- (f) 本公司、杭州鼎轅、田垣力積、鷹溪一號、Eaglestream Partners、鷹溪四號、鷹溪五號、天津灝鑫、杭州蠡元、杭州蠡譽、天童芯安、龍芯立積、龍芯創信、天津鼎鷹、上海翻沐、杭州孚芯、方沛英先生、龍芯聚能、盈富泰克、龍芯創啟、龍芯創溪、龍芯匯裕、天津鼎暉，及深圳長臻訂立日期為2025年4月27日的股東協議（「股東協議」），內容有關本公司若干股東權利及管理；
- (g) 本公司與徐勇戰先生訂立的日期為2025年4月28日的增資協議，據此，徐勇戰先生同意以代價人民幣15,000,000元認購102,919股股份；
- (h) 本公司與徐勇戰先生訂立的日期為2025年4月28日的加入協議，據此，徐勇戰先生同意加入股東協議；
- (i) 本公司、深圳科創鼎暉、Sonder Crescent及天津鼎暉訂立的日期為2025年5月6日的增資協議，據此，深圳科創鼎暉同意以代價人民幣50,000,000元認購343,063股股份，Sonder Crescent同意以代價5,000,000美元認購248,721股股份，及天津鼎暉同意以代價人民幣3,000,000元認購20,584股股份；
- (j) 本公司與深圳科創鼎暉、Sonder Crescent及天津鼎暉訂立的日期為2025年5月6日的加入協議，據此，深圳科創鼎暉、Sonder Crescent及天津鼎暉同意加入股東協議；
- (k) 本公司及浙商佳富訂立的日期為2025年5月7日的增資協議，據此，浙商佳富同意以代價人民幣25,000,000元認購171,532股股份；
- (l) 本公司及浙商佳富訂立的日期為2025年5月7日的加入協議，據此，浙商佳富同意加入股東協議；
- (m) 本公司及浙江和達訂立的日期為2025年5月16日的增資協議，據此，浙江和達以代價人民幣100,000,000元認購686,126股股份；
- (n) 本公司及杭州和達訂立的日期為2025年5月16日的加入協議，據此，杭州和達同意加入股東協議；及
- (o) [編纂]。

## 2. 知識產權

截至最後實際可行日期，我們已註冊或已申請註冊下列對我們業務而言屬重要的知識產權。

### (a) 商標

#### (i) 註冊商標

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	屆滿日期 (日/月/年)
1...	Z-Memory	中國	本公司	9	57318392	13/01/2032
2...	力存	中國	本公司	35	35437571	13/08/2029
3...		中國	本公司	9	53702287	06/09/2031
4...		中國	本公司	9	53703043	06/09/2031
5...	力积存儲	中國	本公司	9	55092086	20/11/2031
6...	Z-Memory	中國	本公司	9	57318380	13/01/2032
7...	Z-Memory	中國	本公司	35	68755562	06/06/2033
8...		中國	本公司	42	68759320	06/06/2033
9...	力存	中國	本公司	9	35448752	13/08/2029
10..	力存	中國	本公司	9	68405596	27/05/2033
11..	力积存儲	中國	本公司	35	68741579	20/08/2033
12..	力积存儲	中國	本公司	42	68742181	06/06/2033
13..		中國	本公司	35	68758534	06/06/2033
14..	Z-Memory	中國	本公司	42	68759322	13/06/2033
15..	力存	中國	本公司	9	68790302	13/08/2033

附錄五

法定及一般資料

序號	商標	註冊地點	註冊擁有人	類別	註冊編號	屆滿日期 (日/月/年)
16 ..	力存	中國	本公司	35	72958263	13/01/2034
17 ..	M2whale	中國	本公司	9	67129133	27/06/2033
18 ..	M2whale	中國	本公司	42	67129147	20/04/2033
19 ..		中國	本公司	9	70967213	06/03/2034
20 ..		中國	本公司	42	78919319	06/12/2034
21 ..		中國	本公司	35	78898693	06/12/2034
22 ..		中國	本公司	9	78913642	06/12/2034
23 ..		中國	本公司	9	78641584	06/11/2034
24 ..	ZHSM	中國	本公司	42	85496305	20/12/2035
25 ..	ZHSM	中國	本公司	9	85476453	20/12/2035
26 ..	力存	香港	本公司	9	306472170	05/02/2024
27 ..	力积存储	香港	本公司	9	306780727	10/01/2035
28 ..	ZENTEL	香港	本公司	9	306781834	13/01/2035
29 ..		香港	本公司	9	306809356	14/02/2035
30 ..	力存	澳門	本公司	9	N/219921	25/06/2031
31 ..	力存	台灣	本公司	9	02437992	28/02/2025
32 ..		日本	Zentel Japan	42	6826361	21/07/2034
33 ..		日本	Zentel Japan	9	6841868	05/09/2034

## 附錄五

## 法定及一般資料

### (ii) 商標申請

序號	商標	註冊地點	申請人	狀態	商標編號	公佈日期 (日/月/年)
1.....		香港	本公司	已發佈	306780727	28/01/2025
2.....		香港	Zentel Japan	已發佈	306781834	21/02/2025
3.....		香港	本公司	已發佈	306809356	28/02/2025

### (b) 版權

#### (i) 註冊版權

序號	版權	版權類別	註冊地點	版權擁有人	註冊編號	註冊日期 (日/月/年)
1...	LJCC方塊印章芯片	作品	中國	本公司	國作 登字-2023-F-00024983	08/02/2023
2...	力存模組彩盒包裝	作品	中國	本公司	國作 登字-2024-F-00089514	28/03/2024
3...	SSD彩盒包裝	作品	中國	本公司	國作 登字- 2025-F-00315474	29/10/2025
4...	自動提取txt文件內容 生成xml文件軟件	軟件	中國	本公司	2024SR0632242	11/05/2024
5...	自動提取XML文件內容 生成Excel文件軟件	軟件	中國	本公司	2024SR0321051	27/02/2024

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	版權	版權類別	註冊地點	版權擁有人	註冊編號	註冊日期 (日/月/年)
6...	巴槍掃碼內存程序	軟件	中國	本公司	2024SR0321067	27/02/2024
7...	溫控裝置的PID參數 優化軟件	軟件	中國	本公司	2023SR1302201	25/10/2023
8...	MRV_Alevel測試軟件	軟件	中國	本公司	2023SR0447953	07/04/2023
9...	DDR4 SLT內存測試 裝備軟件	軟件	中國	本公司	2023SR0194133	02/02/2023
10..	UEFI平臺內存測試軟件	軟件	中國	本公司	2022SR1586582	19/12/2022

### (c) 專利

#### (i) 中國註冊專利

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
1.....	一種延遲鎖定回路	發明專利	本公司	中國	202111082024.2	18/01/2022	15/09/2021
2.....	一種DLL延時鏈及下溢時快速鎖定方法	發明專利	本公司	中國	202210099260.3	14/06/2022	27/01/2022
3.....	一種包含冗餘存儲單元的移位寄存方法 及移位寄存結構	發明專利	本公司	中國	202210856034.5	11/11/2022	21/07/2022

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
4.....	一種數據打散移位寄存結構	發明專利	本公司	中國	202210856032.6	08/11/2022	21/07/2022
5.....	一種半導體器件及其工作方法、存儲器	發明專利	本公司	中國	202211076942.9	27/12/2022	05/09/2022
6.....	輸入信號處理方法及存儲器電路結構	發明專利	本公司	中國	202211076946.7	23/12/2022	05/09/2022
7.....	半導體器件及其操作方法、裝置和 計算機可讀存儲介質	發明專利	本公司	中國	202211226067.8	03/03/2023	09/10/2022
8.....	減小讀出放大器面積的方法、電路及 dram存儲裝置	發明專利	本公司	中國	202211164147.5	03/01/2023	23/09/2022
9.....	一種針對數據屏蔽的糾錯方法、 裝置及存儲介質	發明專利	本公司	中國	202211352755.9	31/03/2023	1/11/2022
10....	訪問字線的方法及字線解碼電路結構	發明專利	本公司	中國	202211550314.X	09/05/2023	5/12/2022
11....	一種三維堆疊存儲器及其數據處理方法	發明專利	本公司	中國	202310105926.6	09/06/2023	13/02/2023
12....	存儲結構	發明專利	本公司	中國	202310089016.3	18/08/2023	16/01/2023

附錄五

法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
13 . . . .	讀取等待時間計數器延遲反饋方法、 延遲反饋存儲結構	發明專利	本公司	中國	202310423019.6	25/08/2023	20/04/2023
14 . . . .	延遲鎖相環路時鐘信號佔空比檢測方法、 佔空比檢測器	發明專利	本公司	中國	202310392614.8	19/12/2023	13/04/2023
15 . . . .	一種延遲鎖相環和延遲鎖相環的鎖定方法	發明專利	本公司	中國	202310330294.3	09/04/2024	30/03/2023
16 . . . .	半導體器件及其校準方法、裝置、 存儲介質和電子設備	發明專利	本公司	中國	202310315927.3	28/05/2024	29/03/2023
17 . . . .	一種存儲器數據寫入方法、裝置、 存儲介質和電子設備	發明專利	本公司	中國	202311016650.0	10/11/2023	14/08/2023
18 . . . .	一種三維存儲器架構及其操作方法和 存儲器	發明專利	本公司	中國	202310998028.8	17/11/2023	09/08/2023
19 . . . .	ZQ校準方法、校準電路	發明專利	本公司	中國	202311042448.5	03/11/2023	18/08/2023
20 . . . .	固定延遲時間實現方法和裝置	發明專利	本公司	中國	202311221141.1	19/12/2023	21/09/2023
21 . . . .	一種移位寄存器和存儲器	發明專利	本公司	中國	202311215775.6	07/05/2024	20/09/2023

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
22 . . . .	移位寄存器和存儲器	發明專利	本公司	中國	202311215761.4	30/01/2024	20/09/2023
23 . . . .	一種時鐘校正電路和存儲器	發明專利	本公司	中國	202311006147.7	24/11/2023	10/08/2023
24 . . . .	用於存儲陣列的熔斷器單元及其 處理方法、存儲陣列	發明專利	本公司	中國	202310824954.3	26/09/2023	06/07/2023
25 . . . .	一種激活預充電反饋電路和存儲器	發明專利	本公司	中國	202311177197.1	26/12/2023	13/09/2023
26 . . . .	用在存儲陣列中的熔斷器單元及其 處理方法、存儲陣列	發明專利	本公司	中國	202311314457.5	23/01/2024	11/10/2023
27 . . . .	在存儲陣列中使用的熔斷器單元及其 處理方法、存儲陣列	發明專利	本公司	中國	202311306618.6	23/02/2024	10/10/2023
28 . . . .	一種三維存儲器架構及其刷新方法和 存儲器	發明專利	本公司	中國	202311686986.8	22/03/2024	11/12/2023
29 . . . .	三維存儲器架構及其刷新方法和存儲器	發明專利	本公司	中國	202311687006.6	08/03/2024	11/12/2023
30 . . . .	讀取等待時間延時反饋電路、反饋方法	發明專利	本公司	中國	202311597666.5	12/03/2024	28/11/2023
31 . . . .	讀取等待時間反饋電路、反饋方法	發明專利	本公司	中國	202311726281.4	02/03/2024	15/12/2023

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
32 . . . .	三維堆疊存儲器架構及其處理方法、 存儲器	發明專利	本公司	中國	202311772980.2	09/04/2024	21/12/2023
33 . . . .	存儲陣列及提高存儲陣列的 數據讀取準確度的方法	發明專利	本公司	中國	202410224395.7	07/05/2024	29/02/2024
34 . . . .	存儲陣列及驅動存儲陣列的方法	發明專利	本公司	中國	202410224439.6	07/05/2024	29/02/2024
35 . . . .	存儲陣列	發明專利	本公司	中國	202410177265.2	07/05/2024	08/02/2024
36 . . . .	半導體存儲裝置及降低其寫恢復時間的 方法、存儲陣列	發明專利	本公司	中國	202410169006.5	03/05/2024	06/02/2024
37 . . . .	一種在存儲器刷新過程中節省能耗的 裝置及方法	發明專利	本公司	中國	202410438368.X	18/06/2024	12/04/2024
38 . . . .	一種動態隨機存儲器讀寫操作結構	發明專利	本公司	中國	202410438335.5	21/06/2024	12/04/2024
39 . . . .	存儲器內部電壓測試系統和方法	發明專利	本公司	中國	202410526909.4	20/08/2024	29/04/2024
40 . . . .	存儲器冗餘字線刷新方法、 裝置、設備和介質	發明專利	本公司	中國	202410627719.1	20/08/2024	21/05/2024

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
41 . . . .	數據輸出方法、裝置、設備和介質	發明專利	本公司	中國	202410709201.2	30/08/2024	03/06/2024
42 . . . .	存儲器字線刷新方法、激活方法、 裝置、設備和介質	發明專利	本公司	中國	202410778744.X	30/08/2024	17/06/2024
43 . . . .	隨機數生成方法、裝置、電子設備和 存儲介質	發明專利	本公司	中國	202411005607.9	8/10/2024	25/07/2024
44 . . . .	一種感測放大器供電電壓的控制裝置	實用新型專利	本公司	中國	202420751162.8	10/12/2024	12/04/2024
45 . . . .	延時測量電路結構、測量方法	發明專利	本公司	中國	202411147839.8	20/12/2024	21/08/2024
46 . . . .	一種基於紅外加熱的內存條恒溫測試裝置	實用新型專利	本公司	中國	202322587991.5	14/05/2024	22/09/2023
47 . . . .	一種內存條測試恒溫系統	實用新型專利	本公司	中國	202322076517.6	06/02/2024	03/08/2023
48 . . . .	一種提升溫度均勻性的翅片結構及 恒溫測試系統	實用新型專利	本公司	中國	202321863659.0	15/03/2024	14/07/2023
49 . . . .	一種內存條測試恒溫裝置	實用新型專利	本公司	中國	202323009692.X	23/08/2024	08/11/2023

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
50 . . . .	一種內存條的電子加熱設備	實用新型專利	本公司	中國	202320311607.6	15/03/2024	24/02/2023
51 . . . .	一種基於神經網絡模型的DRAM 儲存器性能預測方法和系統	發明專利	本公司	中國	202211529939.8	04/06/2024	30/11/2022
52 . . . .	一種使用神經網絡模型的 DRAM存儲器測試方法和系統	發明專利	本公司	中國	202310019573.8	19/07/2024	06/01/2023
53 . . . .	一種基於混合雲的內存自動化測試 方法和系統	發明專利	本公司	中國	202211665140.1	03/09/2024	23/12/2022
54 . . . .	測試服務器機箱(MRV-D5/4S)	外觀設計專利	本公司	中國	202330401062.3	15/03/2024	28/06/2023
55 . . . .	包裝盒	外觀設計專利	本公司	中國	202430089960.4	15/11/2024	21/02/2024
56 . . . .	一種存儲器結構	發明專利	本公司	中國	202411169888.1	07/02/2025	26/08/2024
57 . . . .	一種內存條恒溫測試模組	實用新型專利	成都力積	中國	202322038364.6	15/03/2024	28/07/2023
58 . . . .	內存測試方法、系統及 計算機可讀存儲介質	發明專利	成都力積	中國	202211625081.5	14/05/2024	16/12/2022
59 . . . .	列選通信號控制電路	發明專利	本公司	中國	202411597560.X	22/04/2025	11/11/2024

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
60 . . . .	一種提高存儲單元測試速度的方法及裝置	發明專利	本公司	中國	202510259428.6	13/05/2025	06/03/2025
61 . . . .	一種數據讀取電路的方法	發明專利	本公司	中國	202411435924.4	27/5/2025	15/10/2024
62 . . . .	一種冗餘電路、冗餘地址訪問電路及 訪問方法	發明專利	本公司	中國	202411768323.5	27/5/2025	4/12/2024
63 . . . .	存儲器的刷新電路、刷新方法和存儲器	發明專利	本公司	中國	202510158375.9	30/5/2025	13/2/2025
64 . . . .	DRAM讀寫時序調整電路和DRAM	發明專利	本公司	中國	202510252923.4	27/6/2025	5/3/2025
65 . . . .	快速重新鎖定DLL電路的方法	發明專利	本公司	中國	202111082977.9	29/08/2025	15/09/2021
66 . . . .	一種串行存在檢測信息的自動化燒錄 系統和方法	發明專利	本公司	中國	202510660838.1	05/08/2025	22/05/2025
67 . . . .	存儲器測試方法、裝置、設備和介質	發明專利	本公司	中國	202510744770.5	12/08/2025	05/06/2025
68 . . . .	動態隨機存儲器	發明專利	本公司	中國	202423013003.7	07/11/2025	06/12/2024

附錄五

法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
69 . . .	DLL模塊的電壓監測電路和DRAM	發明專利	Hangzhou Lixin	中國	202510608136.9	01/08/2025	13/05/2025
70 . . .	DLL延遲鏈調整方法和系統	發明專利	Hangzhou Lixin	中國	202510623329.1	12/08/2025	15/05/2025
71 . . .	估空比校正電路校準方法、 系統和存儲器	發明專利	Hangzhou Lixin	中國	202510623360.5	12/08/2025	15/05/2025
72 . . .	自適應SLT測試方法、裝置、設備和介質	發明專利	本公司	中國	202511501968.7	09/01/2026	21/10/2025
73 . . .	基於人工智慧的記憶體測試方法	發明專利	本公司	中國	202511511989.7	24/02/2026	22/10/2025
74 . . .	ZQ校準電路和半導體存儲器	實用新型專利	本公司	中國	202423147521.8	26/12/2025	19/12/2024
75 . . .	一種針對數據屏蔽的糾錯方法、 裝置及存儲介質	發明專利	本公司	中國	202310093549.9	30/12/2025	31/01/2023
76 . . .	DRAM溫度監測自刷新電路和DRAM	發明專利	本公司	中國	202511485094.0	30/12/2025	17/10/2025
77 . . .	內存條SLT測試方法、裝置、設備和介質	發明專利	本公司	中國	202511485342.1	30/12/2025	17/10/2025

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類別	專利 持有人	註冊 地點	專利編號	授予日期 (日/月/年)	申請日期 (日/月/年)
78 . . . .	半導體存儲裝置	發明專利	本公司	中國	202511235197.1	30/12/2025	01/09/2025
79 . . . .	熔斷器檢測電路、熔斷器檢測方法 和半導體存儲器	發明專利	本公司	中國	202511525986.9	06/03/2026	24/10/2025
80 . . . .	存儲器仿真測試向量生成方法、 裝置、設備和介質	發明專利	本公司	中國	202511545040.9	06/03/2026	28/10/2025
81 . . . .	一種提高動態隨機存儲器測試速度的 方法及共享信號選擇電路	發明專利	本公司	中國	202511903136.8	20/03/2026	17/12/2025
82 . . . .	適用於一個硅通路的雙向信號採集 電路及集成電路	發明專利	本公司	中國	202211188755.X	12/05/2026	28/09/2022
83 . . . .	用於電子模塊測試的控溫裝置及測試設備	實用新型專利	本公司	中國	202521262857.0	12/05/2026	19/06/2025

## 附錄五

## 法定及一般資料

### (ii) 日本註冊專利

序號	專利名稱	專利持有人	註冊地點	發佈序號	申請日期	屆滿日期
1....	半導體記憶裝置	Zentel Japan	日本	JP6281030B1	02/08/2017	02/08/2037
2....	半導體記憶システム	Zentel Japan	日本	JP7130634B2	22/05/2017	22/05/2037
3....	半導體記憶システム	Zentel Japan	日本	JP6761104B2	06/03/2017	06/03/2037
4....	半導體記憶裝置	Zentel Japan	日本	JP6147461B1	31/01/2017	31/01/2037
5....	半導體記憶裝置及びテスト方法	Zentel Japan	日本	JP7859712B1	10/07/2025	10/07/2045
6....	半導體記憶裝置	Zentel Japan	日本	JP7803602B1	27/02/2025	27/02/2045

### (iii) 美國註冊專利

序號	專利名稱	專利持有人	註冊地點	申請編號	申請日期
1.....	半導體記憶裝置	Zentel Japan	美國	US11200945B2	31/01/2017
2.....	半導體記憶裝置，包括符合JEDEC標準的接口及其控制裝置	Zentel Japan	美國	US10991418B2	06/03/2017
3.....	用於防止發生行錘問題的半導體記憶裝置	Zentel Japan	美國	US10818337B2	02/08/2017

### (iv) 專利申請

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	申請編號	申請日期 (日/月/年)
1.....	快速重新鎖定DLL電路的方法	發明專利	本公司	中國	2021110829779	15/09/2021

附錄五

法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	申請編號	申請日期 (日/月/年)
2.....	適用於一個矽通路的 雙向信號採集電路 及集成電路	發明專利	本公司	中國	202211188755X	28/09/2022
3.....	一種芯片位置識別方法 及基於該方法的芯片 時序設定方法(二次 提交)	發明專利	本公司	中國	2022111467214	21/09/2022
4.....	一種針對數據屏蔽的糾錯 方法、裝置及存儲介質	發明專利	本公司	中國	2023100935499	31/01/2023
5.....	一種三維存儲器架構和 存儲器	發明專利	本公司	中國	2023105233632	10/05/2023
6.....	一種分隔電荷泵電路 不同輸出電壓的裝置	發明專利	本公司	中國	2024104585906	17/04/2024
7.....	一種延時器延時時間的 檢測裝置及方法	發明專利	本公司	中國	2024104256025	10/04/2024
8.....	ZQ校準電路和半導體 存儲器	實用新型 專利	本公司	中國	2024231475218	19/12/2024

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	類型	專利持有人	註冊地點	申請編號	申請日期 (日/月/年)
9 . . . . .	除法器實現方法、裝置、 設備和介質	發明專利	本公司	中國	202411450244X	17/10/2024
10 . . . . .	動態隨機存儲器	實用新型 專利	本公司	中國	2024230130037	06/12/2024
11 . . . . .	一種數據總線翻轉電路 及方法	發明專利	本公司	中國	2025102150711	26/02/2025
12 . . . . .	基於TFTP服務的內存 測試方法和裝置	發明專利	本公司	中國	202510309261X	17/03/2025

### (d) 域名

序號	域名	註冊擁有人	註冊地點	屆滿日期 (日/月/年)
1 . . . . .	zentel.com	本公司	中國	27/03/2033
2 . . . . .	liji-china.cn	本公司	中國	22/06/2028
3 . . . . .	zentel-japan.com	Zentel Japan	日本	29/10/2025

### (e) 集成電路的佈圖設計

序號	名稱	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	證書編號	授出日期 (日/月/年)
1 . . . . .	4GLPDDR4存儲芯片	本公司	中國	BS.215564758	No. 48334	10/09/2021
2 . . . . .	4GDDR4存儲芯片	本公司	中國	BS21556474X	No. 48439	03/09/2021
3 . . . . .	8GDDR4存儲芯片	本公司	中國	BS.215564782	No. 48442	10/09/2021
4 . . . . .	1GDDR2存儲芯片	本公司	中國	BS.215607112	No. 50715	29/11/2021
5 . . . . .	64MSDR-DDR存儲芯片	本公司	中國	BS.215607236	No. 50716	29/11/2021
6 . . . . .	512MDDR存儲芯片	本公司	中國	BS.215607252	No. 50717	29/11/2021
7 . . . . .	1GDDR3存儲芯片	本公司	中國	BS.215607139	No. 50718	29/11/2021

## 附錄五

## 法定及一般資料

序號	名稱	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	證書編號	授出日期 (日/月/年)
8 . . . . .	F25 1GDDR3存儲芯片	本公司	中國	BS.235564109	No. 70498	09/11/2023
9 . . . . .	F25 512Mb DDR2的集成 電路佈圖	本公司	中國	BS.245566295	No. 81624	14/11/2024
10 . . . . .	F25 4Gb DDR3 ECC的 集成電路佈圖	本公司	中國	BS.245588663	No. 84043	17/02/2025
11 . . . . .	F25 2GD3存儲芯片的 集成電路佈圖	本公司	中國	BS.245605142	No. 85244	03/04/2025

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的知識產權。

### C. 有關董事及主要股東的進一步資料

#### 1. 本公司董事及最高行政人員的權益披露

除下文所披露者外，就董事所知，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事或最高行政人員概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

於本公司的權益

姓名	職位	權益性質	股份類型	非上市 股份數目 <sup>(1)</sup>	緊接[編纂]前 (假設[編纂] 未獲行使)持股量 佔已發行股份 總數的概約百分比	緊隨[編纂]後 持股量佔已發行 股份總數的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
					[編纂]%	[編纂]%
應先生 . . . .	董事會主席兼 非執行董事	受控法團權益	H股	120,430,810	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 所述所有權益均為好倉。
- (2) 該計算乃基於270,000,000股將由已發行非上市股份轉換的H股及[編纂]股將根據[編纂]發行的H股(假設[編纂]未獲行使)作出。

## 2. 主要股東的權益披露

根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，於本公司股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司已發行的投票權股份10%或以上權益的人士的資料，請參閱本文件「主要股東」。

## 3. 服務合約

我們已與各董事就(其中包括)遵守相關法律法規、公司章程及適用的爭議解決規定訂立服務合約或委任函。

除上文所披露者外，本公司概無亦不擬與任何董事就其各自作為董事的身份訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約)。

## 4. 董事薪酬

除「董事及高級管理層」一節以及截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度的「附錄一—會計師報告」附註8中所披露者外，我們的董事均未自本公司獲得其他實物福利薪酬。

## 5. 免責聲明

- (a) 概無董事或任何列於下文「E.其他資料—5.專家資格」的人士為：
  - (i) 於我們的發起，或於緊接本文件日期前兩年內我們已收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
  - (ii) 於本文件日期存續且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關者外，名列下文「D.其他資料—5.專家資格」的人士概無：
  - (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
  - (ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團內任何成員公司任何證券的權利(不論可否依法強制執行)。

## 附錄五

## 法定及一般資料

- (c) 於往績記錄期間各年度，概無董事或彼等的緊密聯繫人或任何據董事所知擁有我們已發行股份數目（不包括庫存股份，如有）5%以上的本公司股東於我們的五大客戶或供應商中擁有任何權益。
- (d) 概無董事為於本公司的股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司的董事或僱員，而相關權益或淡倉於H股在聯交所[編纂]後須立即根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部予以披露。

### D. 其他資料

#### 1. 遺產稅

董事獲告知，根據中國法律，本公司或我們的附屬公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

#### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，董事亦不知悉由或向本集團任何成員公司作出的任何待決或面臨會對本集團經營業績或財務狀況整體產生重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

#### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂]申請批准(i)根據[編纂]將予發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）；及(ii)由我們現有非上市股份轉換的H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使證券可獲納入[編纂]。

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們應付獨家保薦人擔任[編纂]保薦人的費用為500,000美元。

#### 4. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生有關[編纂]的任何重大開辦費用。

#### 5. 專家資格

以下為於本文件提供意見或建議的專家的資格：

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司 . . . . .	根據證券及期貨條例可從事第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動（定義見證券及期貨條例）的持牌法團

## 附錄五

## 法定及一般資料

名稱	資格
競天公誠律師事務所 .....	本公司有關中國法律的法律顧問
霍金路偉律師行 .....	本公司有關美國監管法律及國際制裁法律的法律顧問
安永會計師事務所 .....	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司 .....	獨立行業顧問
Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) ..	本公司有關美國境外投資法律的法律顧問

### 6. 專家同意書

本附錄上文「5.專家資格」所提述的專家已各自就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其證書、函件、意見或報告(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

除本文件所披露者外，上文所列專家並未於本集團任何成員公司擁有任何持股權益或權利(無論可否依法強制執行)以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

### 7. H股持有人的稅項

香港印花稅目前的從價稅率為H股的代價或市值(以較高者為準)的0.10%，將由買方每次購買及賣方每次出售任何香港證券(包括H股)時繳納，即目前每一筆涉及H股的買賣交易共計須繳納0.20%的稅項。此外，H股轉讓文據現時須繳納固定印花稅額5.00港元。如果買賣雙方其中一方為非香港居民且未繳納應付的從價稅項，則未付稅款將根據轉讓文據(如有)進行評估，並由受讓人支付。如果在到期日或之前未繳納印花稅，將可能被處以不超過應繳稅款10倍的罰款。

### 8. 無重大不利變動

董事確認，我們的財務或貿易狀況自2024年12月31日(即編製本集團最近期綜合財務報表的日期)起概無重大不利變動。

### 9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，令所有有關人士受公司(清盤及雜項條文)條例(如適用)第44A及44B條的所有條文(罰則除外)約束。

## 10. 其他事項

- (a) 除「歷史、發展及公司架構」所披露者及與[編纂]有關者外，於本文件日期前兩年內：(i)我們概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；及(ii)本集團任何成員公司概無就發行或出售任何股本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款。
- (b) 本集團任何成員公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權。
- (c) 我們概無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份。
- (d) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (e) 我們並無就任何優先購買權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序。
- (f) 於過往12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們財務狀況構成重大影響的中斷情況。
- (g) 除「監管概覽」一節所披露者外，概無影響我們從香港以外的地方將利潤匯入或將資本調回香港的限制。
- (h) 本公司並無部分股權或債務證券(如有)目前於任何證券交易所或交易系統上市或交易，且目前並無或建議尋求在聯交所以外的任何證券交易所上市或獲准交易。
- (i) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證。

## 11. 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條所規定的豁免而分開刊發。

## 12. 發起人

本公司的發起人包括我們改制為股份有限公司之前本公司於2025年4月25日的所有當時19名股東。除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述關聯交易而已向或擬向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或利益。